

展示会へのご招待

第39回 ネプコン ジャパン

エレクトロニクス開発・実装展

会期 2025年1月22日(水)～24日(金) 10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト

主催 RX Japan株式会社



ご来場には事前登録が必要です(無料)

- 1 下記URLより来場登録
- 2 登録後に発行される来場者バッジをカラー印刷
- 3 来場者バッジ提示でそのまま展示会場に入場

カンタン登録!



受付に並ばず入場できます

『第39回 インターネプコンジャパン』出展のご案内

(総称 ネプコン ジャパン 2025)

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2025 年 1 月 22 日(水)～24 日(金)に東京ビッグサイトにて開催される

『インターネプコンジャパン』へ内藤電誠グループとして出展する運びとなりました。

ご多用とは存じますが、弊社の製品・技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。

なお、今回より来場方法が変更になっております。下記 QR コードまたは URL より事前の来場登録をいただき、弊社ブースへお越しください。心よりご来場をお待ち申し上げます。

敬具

会 期 : 2025 年 1 月 22 日(水)～24 日(金)
会 場 : 東京ビッグサイト 東展示棟 東 1 ホール
ブース番号 : E2-17

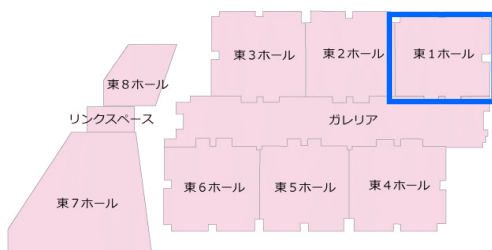


来場者登録はこちら

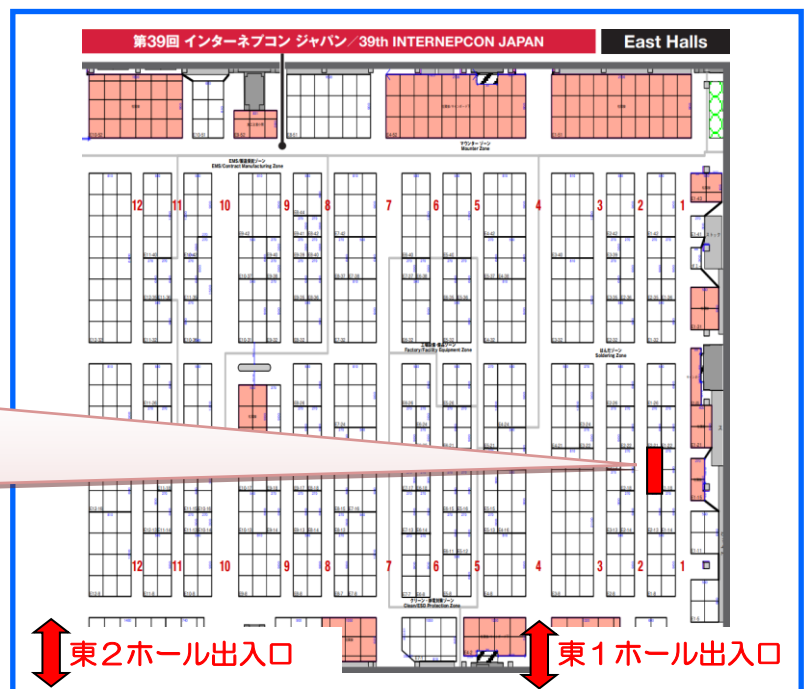
◆事前来場登録 URL

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1220188172073010-SBF>

【ブース位置】

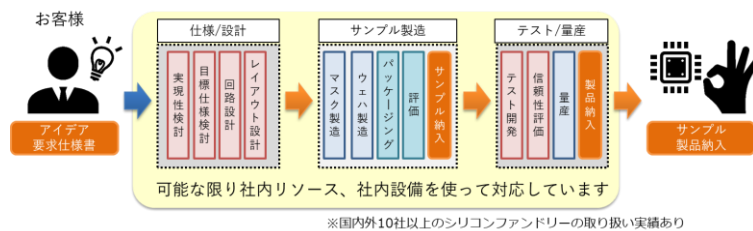


東展示棟 東 1 ホール
E2-17



【出展製品・サービス 一例】

●IC生産ターンキーソリューション



カスタム IC をご検討のお客様に、IC、LSI のターンキーサービスを提供しています。

複数の国内外ファウンドリより、お客様のご要求に最適なプロセスやパッケージをご提案し、試作から量産対応まで承っております。

●半導体パッケージング サービス



試作、少量品から量産品まで、車載品にも対応した国内自社工場で、半導体パッケージの製造受託サービスを提供いたします。

- ・ QFN、QFP、SOP系、DIP系 などの半導体パッケージング
- ・ カスタム仕様の半導体パッケージ製造
- ・ ダイシングやバーンインテストなど製造工程の一部やスクリーニングなど標準外作業

●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・評価～調査解析まで一貫受託サービスで品質向上をサポート致します。

- ・ ISO/IEC17025 試験所認定を取得し、国際標準規格での認定試験が対応可能です。

信頼性評価：各種環境試験(TC, HT, HHT, HHBT, PCT など)、

連続モニタ、リフロー耐熱性試験、染色評価、熱抵抗測定

- ・ 業界トップクラスの X 線 CT 装置で X 線透過や CT 観察で内部欠陥を可視化します。

物理解析：顕微鏡観察、X 線 CT 観察、SAT 観察、PKG 開封、SEM/EDX、
断面加工、レーザー開封、ボンダブル・シェア強度試験、PIND 試験

真贋調査：お客様が調達された製品(IC)をお預かりし、正規品(良品)と調査品(模倣品)の
比較調査(非破壊・破壊)の検証を行います。

内藤電誠工業(株) インターネブコンジャパン担当 行き

Fax. 044-431-7138

E-mail ml.ndkj.e-analog@ndk-grp.jp

■■■ アポイント連絡票 ■■■

ご都合の良いお時間を Fax.または E-Mail にてご連絡お願いいたします。
ご指定の日時に担当者が弊社ブース（受付）にてお待ちしております。

ご来場予定時間： 1 月 日 () 時頃

貴社名： 所属部署：

お役職： ご芳名：

TEL： FAX： E-Mail：

ご商談対象のサービスへ ☒ をご記入願います。

- ☐ IC生産ターンキーソリューション
- ☐ 半導体パッケージング
- ☐ 信頼性評価・調査解析

商談内容やご要望、弊社担当者のご指名などご記入願います。（適任者選定の参考とさせていただきます。）